

NUMBER
178313

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

タブコンタクト
TAB CONTACT

AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

回路番号
CIRCUIT NO

リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL

5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき

3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき

4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき

5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき

6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

	Y	BLACK	6	4	2-178313-5
	X	BLACK	6	3	2-178313-3
	X	BLACK	6	2	2-178313-2
	X	NATURAL	6	4	6-178313-5
	X	BLACK	6	4	1-178313-5
	X	BLACK	6	3	1-178313-3
	X	BLACK	6	2	1-178313-2

キーイング位置 KEYING LOCATION	キーイング KEYING	ハウジング色 HOUSING COLOR	FINISH	製品番号 PART NO.

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME							
mm (AWG)	mm	3 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100							
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)							
E1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14 APR 11	DR.	18 JUN 91	DE.	18 JUN 91	10% ±0.3
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	20 APR 94	APP.	20 APR 94	10% ±0.4
									30% ±0.45
									±3'

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178313
SCALE	REV.	SHEET
2-1	E1	1 OF 1

TE Connectivity

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面